

台湾住友培科股份有限公司 半導体封止材新工場の竣工式について

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：藤原一彦）は、半導体封止材の台湾子会社（台湾住友培科股份有限公司）の半導体封止材の新工場が完成し、2024年3月4日に竣工式を行ったことをごお知らせいたします。

【台湾住友培科股份有限公司 新工場について】

住友ベークライトグループは半導体封止材において、世界でのトップシェア40%（当社推定）を有し、台湾市場では大手唯一の現地生産企業として1999年より生産を開始しています。さらなる成長が見込まれる半導体市場で十分な供給能力を確保するため2021年から新工場の稼働に向けた準備を進めてきました。

3月4日には陳其邁高雄市市長をはじめ、政府関係者、建設にあたってご尽力をいただいた方々をお招きし、竣工式を執り行いました。新工場は正式稼働に向けた作業を進め2024年7月以降生産を開始予定です。



台湾住友培科股份有限公司 半導体封止材新工場

新工場の稼働により台湾住友培科股份の生産能力は従来の2倍となり、台湾半導体市場における地産地消の強みを強化します。

さらに、東南アジアの半導体市場ではシンガポールのグループ会社（Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.）との2拠点体制を整えることで、今後、急成長し、大きな需要が見込まれるパワー半導体や車載半導体の用途に向けて、最新鋭の技術・最高品質の商品とサービスで確実に応えていきます。

2024年3月4日 台湾住友培科股份有限公司 半導体封止材新工場竣工式



台湾住友培科股份有限公司 半導体封止材新工場竣工式にて



高雄市長 陳其邁氏

台湾の多くの先端プロセス研究開発企業などが高雄への投資を加速しており「高雄市は、将来的には世界の半導体産業の新たな中心地の1つとなるだろう」と期待を述べられました。

また、住友ベークライトグループの技術と地元企業の支援による台湾住友培への投資は高雄市が推進する石油化学産業の変革を加速させるものであるとの祝辞をいただきました。



住友ベークライト株式会社  
社長 藤原 一彦

台湾住友培科は1999年から高雄で半導体封止材の生産を行ってきており早いもので25年を迎えようとしております。

新工場による供給能力増強は長期的成長を続ける台湾半導体市場産業において地産地消の力をより一層強化するものであり私たちの役割と使命を強く感じております。

今後も台湾経済の発展に貢献できるよう従業員一同がより一層の努力を重ねて業務に邁進してまいります。

本件のお問合せ先：住友ベークライト株式会社情報通信材料営業本部 TEL: 03-5462-4015

[https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j\\_itmaterials\\_epoxy](https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_itmaterials_epoxy)

このリリースに関するお問い合わせは  
コーポレートコミュニケーション部  
広報担当まで

〒140-0002  
東京都品川区東品川2丁目5-8  
天王洲パークサイドビル

TEL (03) 5462-4818  
FAX (03) 5462-4873  
WEBSITE <https://www.sumibe.co.jp>